

就業機構基本資料表:填表日期 113年05月22日

公司名稱	凌嘉科技股份有限公司				
負責人	陳連春	統一編號	70626771		
聯絡人	王彩婷				
聯絡人電話	04-24608771#134	E-mail	laura.wang@lincotech.com.tw		
就業地點	台中市西屯區科園一路 16 號				
公司簡介	<p>凌嘉科技成立於 1999 年，擁有來自半導體設備、IC 封裝、光電科技產業等不同領域的專業技術團隊，專注於核心技術(薄膜製程、電漿技術、智能化、自動化)、製程設備產品及散熱模組開發。市場佈局跨足半導體先進封裝、半導體先進載板材料、次世代顯示器、先進散熱基板、綠能科技應用與化合物半導體等產業。</p> <p>凌嘉科技於 2010 年領先業界開發出 SiP 系統封裝關鍵製程之 Conformal shielding 鍍膜設備，應用於 B5G 智能手機、穿戴裝置、IoT、V2X 等領域。</p> <p>凌嘉以全方位的薄膜製程技術解決方案，提供客戶高品質與信賴性的製程設備與技術支援服務，並成為全球先進半導體系統級封裝 (SiP) 濺鍍設備市佔率第一，世界級標竿企業！</p>				
甄選方式	Email 或 電洽				
輪班	<input checked="" type="checkbox"/> 否 工作 <u>8</u> 時 <input type="checkbox"/> 是 做 <u> </u> 休 <u> </u>		加班時間	<input checked="" type="checkbox"/> 是 每週 <u>30</u> 時(含) 以下	
系別	工作項目內容	名額	薪資	需求條件或專長	備註
機械與電腦輔助工程系、自動化工程系、機械設計工程系	職缺名稱：機械設計工程師 1. 機械與機構設計、工程圖面設計。 2. 組合圖、BOM 建立、設計維護與更新。 3. 設備組裝指導、功能驗證執行。 4. 真空系統設計、模組功能驗證。	3	面議	1.機械設計、機械材料、機械製圖。 2.產品機構設計。 3.繪製 2D/3D 模具設計圖。	需檢附大學/研究所成績單
機械與電腦輔助工程系、自動化工程系、機械設計工程系	職缺名稱：自動化機械設計工程師 1.設備開發設計與自動化規劃。 2.自動化設備組裝指導、功能驗證執行、組裝測試與檢討。 3.機構設計圖面繪製、BOM 建立、設計維護與更新。 4.自動化產品應用，制訂規格書	3	面議	1.機構設計與繪圖、傳動設計 2.結構分析、可靠性評估	需檢附大學/研究所成績單

<p>自動化工程系、電機系、電子系</p>	<p>職缺名稱：客服(設備維修)工程師</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 客戶端技術售後服務與設備機台維護保養服務。 2. 設備機台操作與維護的教育訓練。 3. 客戶端設備機台安裝及交機驗收。 4. 設備機台組裝及出貨前功能測試。 5. 客戶滿意度調查及客訴處理。 6. 機台操作手冊及相關資料建立。 	<p>3</p>	<p>32,000~45,000</p>	<p>1.需有 PLC 程式/HMI 人機介面軟體、伺服馬達、變頻器、Auto CAD 等相關知識 2.具外語能力</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需檢附大學/研究所成績單 2. 需檢附英文或其他外語相關檢定
<p>動力機械工程系、電機工程系、電子工程系</p>	<p>職缺名稱：設備組立工程師</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.廠內機台組裝工作(機構組立及機台配線)。 2.帶領/教導外包商進行組立相關作業。 3.出貨前機台功能測試。 4.支援客戶端機台裝機及驗收。 5.電機設備保養修護。 6.機械產品故障排除檢修。 5.配合公司短期國內出差。 	<p>2</p>	<p>32,000~45,000</p>	<p>1.電機設備測試、自動化機構裝配相關知識。 2.具電力訊號的配線控制知識。 3.具工業配線、電子電路配線、機械識圖能力。</p>	<p>需檢附大學/研究所成績單</p>
<p>機械與電腦輔助工程系、自動化工程系、機械設計工程系</p>	<p>職缺名稱：工程整合工程師</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新產品開發設備、模組組裝，測試工作。 2. 新產品開發項目組裝、測試期間的問題紀錄及回饋。 3. 開發完成的設備技術於轉移至其他部門階段，擔當現場的教官，輔導其他部門承接。 4. 既有研發測試機台的例行保養、管理、維護、與必要的修繕。 	<p>3</p>	<p>面議</p>	<p>1.電機設備保養修護。 2.新技術製程開發。 3.改善設備問題及功能提昇。</p>	<p>需檢附大學/研究所成績單</p>
<p>機械與電腦輔助工程系、自動化工程系、機械設計工程系、電機系、電子系</p>	<p>職缺名稱：電控製圖助理工程師</p> <p>新機台電控認證、製圖。</p>	<p>1</p>	<p>30,000~40,000</p>	<p>1. 電路製圖。 2. 機器人/PLC/人機知識。 3. 待人誠懇，具工作熱忱、有上進心與人互動良好及溝通能力佳。 4. 具有證照者尤佳。 5. 應屆畢業生可於畢業後，歡</p>	<p>需檢附大學/五專成績單</p>

									迎加入團隊。	
材料科學與 工程系、及其他 化工、物理 相關學系	職缺名稱：專案製程開發工程師 1. 厚銅/薄銅新產品開發與測試。 2. 新產品製程開發、量產導入、 文件撰寫。 3. 產品品質優化與良率改善。 4. 製程/材料/設備評估及改善。 5. 其他主管交辦事項或專案等。			3	32,00 0~45, 000	1.材料評估測試 2.化學製程研發 3.製程相關技術開發				1.需檢附 大學/研究 所成績 單。 2.工作 地：雲林 土庫
不拘	職缺名稱：技術員(早班) 機台操作、顯微鏡量測、定量分析			5	30,00 0	待人誠懇，具工作熱忱、有上 進心與人互動良好及溝通能 力佳。				工作地： 雲林土庫
不拘	職缺名稱：技術員(中班) 機台操作、顯微鏡量測、定量分析			10	30,00 0(起)	待人誠懇，具工作熱忱、有上 進心與人互動良好及溝通能 力佳。				工作地： 雲林土庫
公司福利	交通津貼	伙食	宿舍	勞保	健保	意外險	勞退	其他		
	<input type="checkbox"/> 免費 <input checked="" type="checkbox"/> 不提供	<input type="checkbox"/> 提供 <input checked="" type="checkbox"/> 不提供	<input type="checkbox"/> 提供 <input checked="" type="checkbox"/> 不提供	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	員工分紅配股：年終紅利、員工認股、其他激勵計畫。 獎金制度：年終獎金、專案獎金、專利獎金、績效獎金。 健康：定期員工健康檢查。節慶禮金、勞動禮金、生日禮金、年度旅遊、部門聚餐、各項津貼補助、教育訓練計畫	

* 配合個資法的實行，請留公司的聯絡電話及E-mail，謝謝~

* 薪資未達"4萬"之職缺，依相關規定不可填寫"面議"，表格若不夠填寫，請自行增列，謝謝。